

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2013年9月19日(19.09.2013)



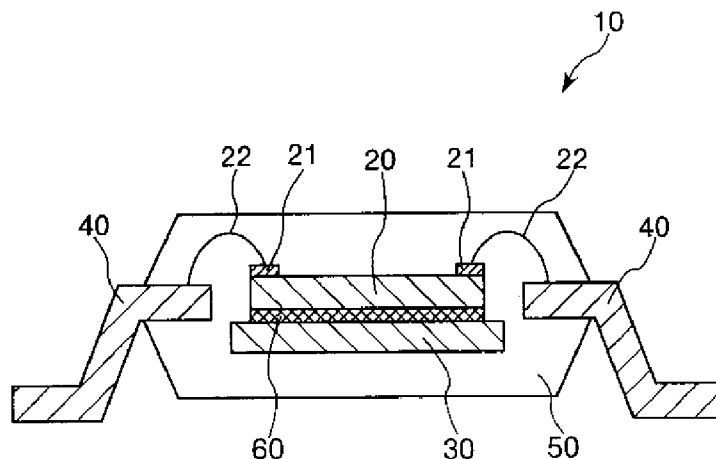
(10) 国際公開番号
WO 2013/136685 A1

- (51) 国際特許分類:
C08L 63/00 (2006.01) H01L 23/29 (2006.01)
C08G 59/32 (2006.01) H01L 23/31 (2006.01)
C08G 59/62 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2013/001088
- (22) 国際出願日: 2013年2月26日(26.02.2013)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2012-061136 2012年3月16日(16.03.2012) JP
特願 2012-061137 2012年3月16日(16.03.2012) JP
- (71) 出願人: 住友ベークライト株式会社(SUMITOMO BAKELITE CO., LTD.) [JP/JP]; 〒1400002 東京都品川区東品川2丁目5番8号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 吉田 顕二(YOSHIDA, Kenji); 〒1400002 東京都品川区東品川2丁目5番8号 住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP). 鵜川 健(UKAWA, Ken); 〒1400002 東京都品川区東品川2丁目5番8号 住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP). 田中 祐介(TANAKA, Yusuke); 〒1400002 東京都品川区東品川2丁目5番8号 住友ベークライト株式会社内 Tokyo (JP).
- (74) 代理人: 速水 進治(HAYAMI, Shinji); 〒1410031 東京都品川区西五反田7-9-2 五反田TGBビル9階 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーロパ (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

[続葉有]

(54) Title: SEALING RESIN COMPOSITION AND ELECTRONIC DEVICE USING SAME

(54) 発明の名称: 封止用樹脂組成物およびこれを用いた電子装置



(57) Abstract: Provided are: a resin composition for sealing electronic components which comprises a phenol resin curing agent and an epoxy resin, either of the phenol resin curing agent or the epoxy resin having a biphenyl structure; a resin composition for sealing electronic components which comprises a phenol resin curing agent and an epoxy resin, and has a glass transition temperature of a cured product of 200°C or more and a weight loss rate of 0.3% or less; and an electronic device which comprises electronic components that are sealed with said resin composition.

(57) 要約: 本発明によれば、フェノール樹脂硬化剤とエポキシ樹脂とを含み、前記フェノール樹脂硬化剤および前記エポキシ樹脂のいずれかがビフェニル構造を有する、電子部品封止用の樹脂組成物、フェノール樹脂硬化剤とエポキシ樹脂とを含み、硬化物のガラス転移温度が200°C以上であり、重量減少率が0.3%以下である、電子部品封止用樹脂組成物、ならびに上記樹脂組成物で封止された電子部品を備える電子装置が提供される。

WO 2013/136685 A1

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第 21 条(3))